

첨단반도체공정장비 융합전공 2024-2학기 학생 모집

■ 첨단반도체공정장비 융합전공 소개

1. 이수자 특전

- 가. 첨단반도체공정장비 융합전공 과목 한학기 12학점 이상 취득 및 평점평균 3.0이상인 자에게 해당학기 등록금 전액 장학금 지급(최대 두학기 지급) / 초과학기생은 장학금 지급 불가
- 나. 융합전공 재학생 전원에게 국내외 현장실습 수행 지원비 전액 지급/ 초과학기생도 지급 가능

2. 교육과정(2024학년도 2학기 기준)

이수 구분	학수번호	교과목명	권장 이수 학년/학기*	학점 (시간)	이론/실습	비고
전공 필수	EIEN346	센서공학	3/2	3(3)	이론	
	EMSE335	CAD	4/1	3(3)	이론	
	EIEN234	AI-빅데이터공학수학	4/2	3(3)	이론	
	DSSP375	반도체공정실습및캡스톤디자인	4/1	3(5)	이론및실습	택1*(변경예정)
	EIEN320	반도체제작기술	3/2	3(3)	이론	
	EIEN378	광공학	3/2	3(3)	이론	
	EIEN342	패턴인식과기계학습	3/2	3(3)	이론	
	DSSP411	열및통계물리학 I	4/1	3(3)	이론	
	DSDC477	공정플라즈마개론	4/1	3(3)	이론	
	DSDC478	플라즈마공정및장비	4/2	3(3)	이론	
EMSE309	계측공학 I	4/1	3(3)	이론		
전공 선택	EMSE346	진동공학	3/2	3(3)	이론	
	EMSE246	마이크로프로세서	3/2	3(3)	이론	
	ASPE310	진공공학	3/2	3(3)	이론	
	DSSP379	반도체계면공정	3/1	3(3)	이론	
	AISE303	마이크로프로세서응용	4/1	3(3)	이론및실습	
	AISE401	광메카트로닉스	4/1	3(3)	이론	
	AISE403	반도체자동화시스템	4/1	3(3)	이론	
	EIEN461	디지털통신	4/1	3(3)	이론	신규*(변경예정)
	EICI201	KUS 전공특화현장실습 I		3(0)	인턴십	신규*(변경예정)
	EICI202	KUS 전공특화현장실습 II		3(0)	인턴십	신규*(변경예정)
	EICI203	KUS 전공특화현장실습 III		3(0)	인턴십	신규*(변경예정)
	EICI204	KUS 전공특화현장실습 IV		3(0)	인턴십	신규*(변경예정)
	EICI205	KUS 전공특화현장실습 V		3(0)	인턴십	신규*(변경예정)
	EICI206	KUS 전공특화현장실습 VI		3(0)	인턴십	신규*(변경예정)

* 권장 이수 학년/학기는 참고용으로 융합전공 신청자는 졸업요건에 맞춰 수강 가능함

3. 첨단반도체공정장비융합전공 이수 요건

- 가. 융합전공 교과목 총 36학점 이수
- 나. 필수 4과목(12학점) 이수
- 다. 반도체기업 인턴십(비교과프로그램) 160시간 이수 또는 반도체관련 현장실습 6학점 이수*(변경예정)

*** (변경예정)은 2024학년도 2학기부터 반영 예정**

■ 첨단반도체공정장비 융합전공 지원

1. 지원자격 : 반도체특성화대학지원사업 참여학과* 소속 재학생(2024년 1학기 기준 3학기(편입학기) 이상 이수자)

*전자및정보공학과, 전자기계융합공학과, 디스플레이반도체물리학부, 지능형반도체공학과

2. 지원기간 및 방법

가. 지원기간: 2024. 4. 15.(월) 10:00 ~ 4.17(수) 17:00

나. 지원방법: 포탈 시스템 신청(포탈시스템 > 학적/졸업 > 학적사항 > 융합전공 신청)
 학업계획서 작성(지원동기, 관심분야 및 관심과목, 학업계획, 기타)

※KUPID 게시판 > '2024년도 제2학기 융합전공전형 시행 안내' 참고

3. 합격자 발표: 2024. 5. 10.(금) 17시(예정) /문의. 044-860-5897, kusemicon@korea.ac.kr

■ 기타 첨단반도체공정장비 융합전공 학생 주요 지원 사항

1. 우수 학부연구생 프로그램 INSERT(IN Semiconductor Research Training) 참여
2. 첨단반도체 공정장비 전문가 초청 정보교류 세미나 개최(연 8회)
3. 첨단반도체 공정장비 취업 특강, 포럼, 설명회 개최
4. 국내 반도체 학술대회 참여 지원
5. 국외 GST-AST 프로그램 참여 지원
6. 반도체 기업 인턴십 지원



반도체특성화대학지원사업
GST-AST 프로그램 선발

신청기간: 2024. 4. 14. (일) 24:00까지

연수기간: 2024. 6. 16. (일) ~ 2024. 6. 20.(목)

방문학회: 2024 IEEE Symposium on VLSI Technology & Circuits

일차	주요 내용
1차	특이 도식, 우수 이동
2차	반도체 특성에 맞는 최신 기술에 관한 short course 수강
3차	반도체 특성에 맞는 최신 연구에 관한 technical sessions 세미나 참여 및 초청 강연 발표
4차	미국, 한국

신청대상: 24학년도 1학기 첨단반도체공정장비 융합전공 학과 중 해당 전공과목 12학점 이상 이수자
 24학년도 1학기 융합전공 신청서 작성 완료 후 24학년도 1학기 출석성 채점
 신청인원: 10명
 신청 및 선발 공시사항 참고
 선발방법: 1. 1차: 2024학년도 2학기 학적원 첨단반도체 공정에 융합전공 지원 평균합점 90% 시점부터 참여 가능(최소 50%)
 2. 2차: 학적원기시제에 모든 취득학점의 평균 합산성취율
 참여 학과: 국외(연수 비용 전액 무료/간편비용은 개인 지출)
 * 자세한 사항은 방문 공시사항 참고
 * 문의사항: 첨단반도체공정장비인재양성사업단
 kusemicon@korea.ac.kr | 044-860-5897



제3회 첨단반도체 공정장비 산업 전문가 초청 세미나

일시: 2024. 04. 17(수) 16:30 ~ 18:30
 장소: 고려대 세종캠퍼스 농심극제관 108호

강연자: Cohu社 고진수 부사장
 반도체 테스트 장비 이온 및 기술 동향
 (주)셀테크 박근주 연구소장
 식각 장비 이온 및 기술 동향

*반도체특성화대학지원사업 마일리지 6점 적립
 *주최·주관: 첨단반도체공정장비인재양성사업단

■ 반도체특성화대학지원사업 소개

1. 개요

‘반도체 특성화대학지원사업’은 「반도체 관련 인재 양성방안」(2022.7.19.)에 따라 산업계 인력 수요에 대응하여 반도체 (학부)교육 역량과 의지를 갖춘 대학을 집중 육성하고자 2023년 신설된 교육부 인재양성 사업

2. 사업기간 및 예산 : '23. 3. 1. ~ '27. 2. 28.(4년(2+2)) 총 280억원

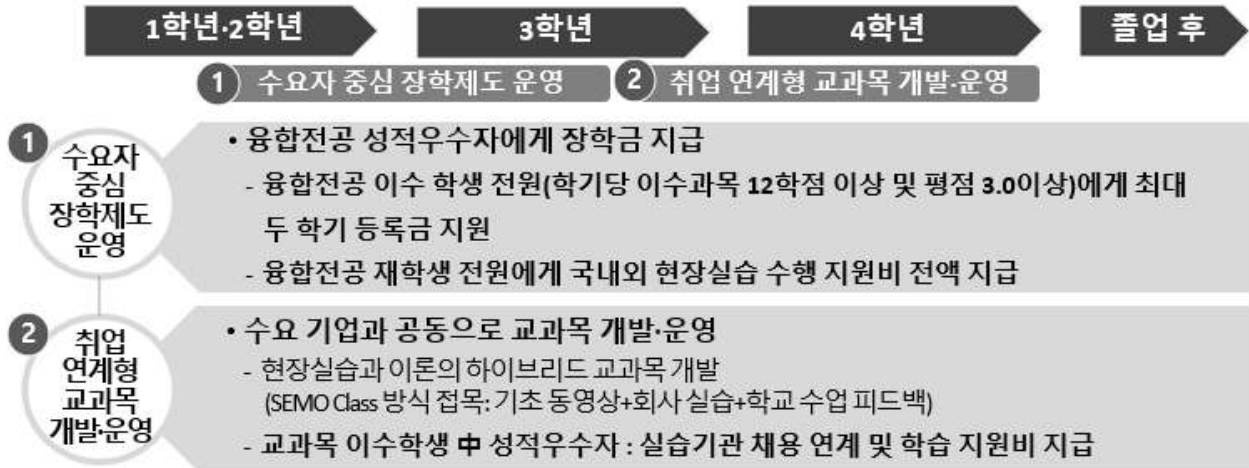
■ 고려대학교 세종캠퍼스 반도체특성화대학지원사업 비전 및 전략



1) INCERT(In Semiconductor Equipment Research Training): 우수 학부 연구생이 대학원생 멘토와 함께 첨단 반도체 공정장비 관련 연구주제를 진행하는 프로그램

2) SEMO(Student Engaged MOdular): (온라인) 동영상 + 소그룹 활동 + (오프라인) In-Class로 이어지는 Flipped Learning의 교육 유형

■ 반도체특성화대학지원사업 이수자 특전



■ 반도체특성화대학지원사업 교육·실습 환경 구축 계획

국내 최고 수준의 반도체 일관 공정 라인(클린룸) 구축

